

公司代码：688655

公司简称：迅捷兴

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅 2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为13,469,654.44元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税)，截至2023年12月31日，公司总股本为13,339万股，以此为基数计算，预计派发现金红利总额为10,004,250.00 元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的74.27%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额；该利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	迅捷兴	688655	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

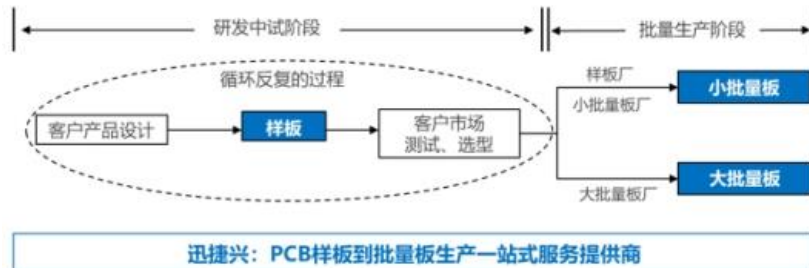
联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吴玉梅	
办公地址	深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋	
电话	0755-33653366	
电子信箱	zqb@jxpcb.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

(1) 主要业务

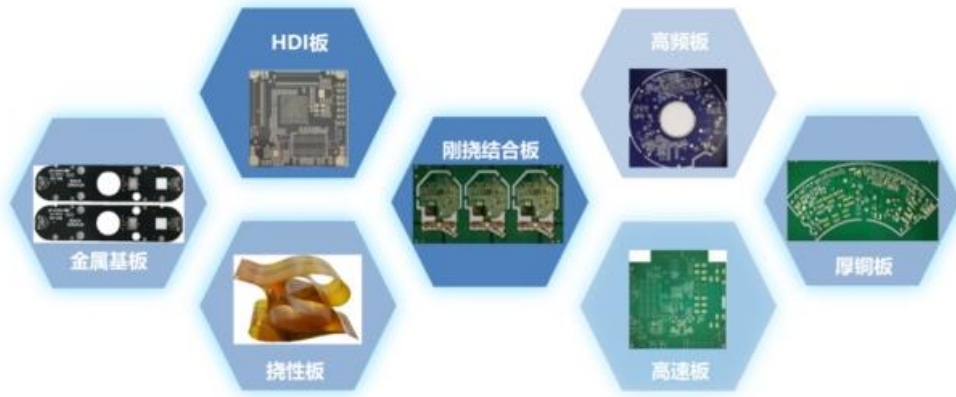
公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，产品和服务以“多品种、小批量、高层次、短交期”为特色，致力于满足客户产品生命周期各阶段的需求，提供从样板生产到批量板生产的一站式服务，满足客户从新产品开发至最终定型量产的 PCB 需求。



目前，国内 PCB 企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的 PCB 企业。

(2) 公司产品及其用途

公司技术能力全面，产品种类丰富。可根据客户需求提供多样化的产品，种类覆盖了 HDI 板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等多种特殊工艺和特殊基材产品。



公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、新能源光伏储能、安防电子、工业控制、医疗器械、轨道交通等领域。汽车电子领域，公司产品主要应用于智能座舱、智能驾驶系统、自动驾驶雷达、智能影音系统、自动驾驶监控系统、尾气排放检测、智能导航及车联网、充电桩等；通信设备领域，公司产品主要应用于 5G 天线、基站设备、服务器、交换机、存储器、滤波器、功放器、移项器、光电模块、路由器、连接器等；光伏储能方面，公司产品主要应用于光伏逆变器、光伏控制器、电池组、电池管理系统等；安防电子领域，公司产品主要应用于监控摄像头、热成像仪、人脸识别一体机、数字视频录像机等；工业控制领域，公司产品主要应用于交流伺服系统、机器手臂驱控一体控制系统、工业计算机等；医疗器械领域，公司产品主要应用于呼吸机、监护仪、血糖仪、血氧机、除颤仪、心电诊断仪器、影像诊断设备等；轨道交通领域，公司产品主要应用于烟雾报警系统、车外窗显示系统、继电器等。



（二） 主要经营模式

（1） 采购模式

公司产品涵盖 PCB 样板和批量板，生产所需原材料的规格、型号、品种较多，因此公司原材料采购具有采购频率高、单次采购量小、品类多的特点。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、金盐、铜箔、铜球、干膜、油墨等。通常情况下，公司主要原材料向制造商直接采购，其他品种多、采购量小的辅材则主要通过贸易商采购。对于常备物料，公司在保证安全库存的前提下，按生产计划安排采购；对于非常备物料，公司按实际生产需求安排采购。

为保证原材料采购的品质、交期的稳定性，规避采购风险，公司制定了《供方评定控制程序》，对供应商的开发、管理、评审进行规范。

（2） 生产模式

公司 PCB 样板和批量板均采用按订单生产的模式。其中 PCB 批量板针对的是新产品定型后的批量生产阶段，单个品种的需求量较大，生产主要体现为制板过程，定价依据主要体现为制板费。而 PCB 样板针对的是新产品定型前的研发、中试阶段，单个品种的需求量小，在线品种多，对公司柔性化生产管理要求较高。PCB 样板的生产过程既包括制板过程，也包括工程处理、模具制作等非制板过程。生产流程如下：

营销中心在接到客户订单后，将客户技术文件交由工程部进行订单预审，识别常规订单和非常规订单。通常情况下，客户提供的设计文件需经公司工程技术人员审查、补正、优化，并转换成工程文件后，才可编制用于生产指导的制造说明。

计划部根据制造说明、出货需求、样品需求、以及客户的交期，依据原材料库存情况、工序产量目标及生产周期一览表编制每日生产作业计划，并分发给工程部、物控部、品质部、生产部各工序。

生产部管理人员通过生产流程卡、作业指导书等内容得到拟生产产品的特性信息，并依照工艺流程、作业指导书等实施生产工艺排序和作业准备，同时确保生产用原材料、辅料等器材与要求一致。

生产部根据生产排程表进行生产，并对生产过程进行记录，保证过程可追溯性。

（3） 销售模式

公司采取“向下游制造商直接销售为主、通过贸易商销售为辅”的销售模式。公司一般与主要客户签定框架性买卖合同，约定产品的质量标准和交货方式、结算方式等；在合同期内，客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求，销售价格、数量等。

公司销售分为国内销售和出口销售。为了快速响应客户需求，公司国内销售以直销为主，主要区域为华南和华东。公司出口销售主要通过贸易商进行，出口销售国家主要包括德国、英国、美国等。

（4）研发模式

技术中心根据公司经营计划并结合行业前沿技术发展方向制订研发计划，经详细的技术、市场、产品等方面的调研后拟定研发项目。技术中心根据研发项目的难易程度，分步骤、分时段、分人员进行不同研发项目之间的统筹安排。公司研发流程分为立项阶段、方案阶段、试样阶段和批量阶段四个阶段。研发项目实施过程中，技术中心对新工艺流程进行梳理并形成技术规范文件；研发项目结项通过后，公司及时启动专利申请对知识产权进行保护。

（三） 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业属于“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业(代码 C39)”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

印制电路板(简称“PCB”)是电子产品的关键电子互连件，几乎每种电子设备都离不开 PCB，有“电子产品之母”之称。

（2）行业发展阶段及基本特点

2023年，受全球经济增长乏力，地缘政治冲突持续不断叠加通胀高企等诸多不确定因素影响，PCB 市场需求依然疲软，行业竞争加剧。根据 PrismaMark 2023 年第四季度印制电路板行业报告，2023 年全球 PCB 行业产值为 695.17 亿美元，同比减少 15%；2023 年国内 PCB 市场产值达 377.94 亿美元，同比下降 13.2%。

但从中长期来看，随着人工智能、汽车电子、云计算等下游应用行业的拓展，未来 PCB 行业产值将保持稳定增长。据 PrismaMark 预测，全球 PCB 行业在 2023 年至 2028 年复合增长率为 5.4%，

呈现持续性增长趋势；中国市场 2023 年至 2028 年复合增长率为 4.1%，低于行业整体增长，主要原因在于全球供应链和 PCB 产业受政策因素影响逐步转移东南亚，在资源有限的情况下形成挤出效应。预期 2024 年 PCB 行业将实现恢复性增长，整体规模达到 729.71 亿美元、同比增长 4.97%。

从地区发展来看，全球 PCB 制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，中国大陆依旧占据了世界第一的重要地位。

从下游应用来看，PCB 行业下游应用领域广泛，包括通信、消费电子、计算机、网络设备、工业控制、汽车电子、航空、医疗等。广泛的应用分布为行业提供巨大的市场空间，也降低了行业发展的风险。

当前，全球新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，云计算、大数据、人工智能、汽车电子、5G 通信等新技术、新应用不断涌现、发展。未来新一代信息技术将成为引领经济发展的引擎，将驱动 PCB 行业进入新一轮发展周期。

（3）主要技术门槛

PCB 行业属于技术密集型行业，制造工艺复杂，工艺流程涵盖钻孔、电镀、蚀刻、阻焊等多道工序，涉及到材料、电子、机械、光学、化工等多学科技术，需要 PCB 制造企业具备较强的工艺技术。

PCB 应用领域细分行业众多，产品种类亦十分繁杂，应用于不同领域或相同领域不同功能的 PCB 产品的技术要求差异较大，需要根据客户定制化要求进行生产及提供解决方案。PCB 企业的工艺技术水平不仅取决于生产设备的配置，更来源于企业生产经验和技术的不断积累。随着电子产品日益朝智能化、轻薄化、精密化方向发展，其对于 PCB 产品的技术先进性及稳定性要求日益提高，生产企业必须拥有先进的生产设备、精湛的生产工艺及不断创新的生产技术以应对行业的不断技术革新。因此，进入 PCB 行业的技术壁垒将日益提高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据 CPCA 公布的《第二十二届中国电子电路行业排行榜》，内资 PCB 百强企业中，公司排名 76 位，同时公司在专业从事样板和小批量板的细分领域企业中位居前列，被 CPCA 评为内资 PCB 企业“快板/样板”特色产品主要企业。

公司起步于样板，经过多年在 PCB 样板领域的深耕，公司积累了大量的客户资源、成熟的工

艺技术。为了更好地服务于样板客户产品研发成功后的批量阶段的需求，配合客户批量订单的导入，公司在业务上做出了自然的延伸，于 2016 年底顺利实现向“样板到批量生产一站式服务模式”演变。目前，国内 PCB 企业多以大批量业务为主，专注于样板业务的企业较少。公司业务涵盖样板、小批量板和大批量板，是行业内为数不多可以为客户提供从样板到批量生产一站式服务的 PCB 企业。

报告期内，公司坚持走特色化发展路线，努力发挥样板生产到批量板生产一站式服务优势，利用样板、小批量板领域前期积累的丰富技术经验和客户资源，深挖原有大客户需求，并积极拓展新能源汽车、智能座舱、光伏储能、5G 通讯、物联网、人工智能等领域，为公司未来的发展开拓了更广阔的市场空间，并进一步提高了公司市场占有率。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司坚持以市场为导向，持续跟踪下游客户应用需求以及行业发展趋势，力争把握前沿市场发展机遇，并不断取得技术创新和突破。

(1) 新兴市场应用驱动 PCB 需求持续增长

汽车电动化、智能化发展驱动 PCB 量价齐升

汽车新四化发展使汽车电子具体应用增加，PCB 多样化要求将会增加。根据中商产业研究院数据，未来汽车电子化水平将持续增长，预计在 2030 年汽车电子成本占整车成本约 50%，汽车电子 PCB 将因此得到长足发展。根据 Verified Market Research 预测，2021-2028 年汽车 PCB 市场将保持增长，区间 CAGR 为 5.30%，市场规模将提升至 2028 年 124.80 亿美金。

智能化的 PCB 增量主要来源于 ADAS 和智能座舱。目前，我国 ADAS 系统渗透率不高，市场成长空间广阔。目前智能座舱技术成熟度更高，且有着强烈的用户需求，在智能汽车的布局中占据越来越重要的地位。据 IHS Markit 预测，智能座舱在中国/全球的渗透率将从 2019 年的 35%/38% 上升至 2025 年的 76%/59%。

报告期，公司积极瞄准汽车电子智能驾驶和智能座舱发展带来市场机遇，凭借已有客户储备，深挖订单，进一步提升了智能驾驶、智能座舱、车灯等产品领域市场份额。未来，公司将大力发展汽车电子业务，大幅提高市场份额。

数据中心高速建设，新场景新应用打开新的增长空间

AIGC 行业发展趋势明确，亦加速云计算建设需求，在此浪潮之下，为支撑高密度计算需求大规模、标准化、模块化，数据中心（IDC）相关建设需求迎来快速成长，根据中国信通院数据显示，服务器在数据中心建设成本结构中占比达 69%，将受益 IDC 建设。同时，数据中心的建设亦带动相应网络设备、储存设备、安全设备、光模块/光纤/网线等需求随之高速增长。

为此，随着全球数字化建设持续推进，亦有 ChatGPT 等新兴技术引发科技巨头算力军备竞赛，同时算力性能提升对 PCB 传输速率、层数、材料等提出更高要求，Prismark 预测 2026 年全球服务器及数据中心/有线侧通信设备 PCB 产值将达 132.94/79.01 亿美元，对应 2022~2026 年复合增长率为 9.4%/4.2%。

随着 5G 网络建设的大规模推进及商用，将催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合。由于 5G 通信基站建设量大幅增加，应用于 5G 网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对 PCB 的需求增加，PCB 使用量将相应增长。

报告期，公司紧抓服务器、光模块和交换机以及 AI 相关产品领域技术研发，不断突破样品、批量交付。未来公司将继续加大技术研发和相关市场开发力度，以把握数通领域市场发展机遇。

（2）技术发展持续推动 PCB 产品结构升级

受益于下游应用技术规格持续迭代升级，对线路板要求亦不断提升，PCB 下游中高端化产品如 HDI、封装基板等产值占比显著提升。伴随产品性能的不断升级，高附加值产品产值有望维持快速增长。

未来公司将围绕高频高速、HDI、软硬结合板、金手指板等重点产品持续加大研发投入，提高工艺技术能力，提高产品竞争力，以不断优化产品结构。

（3）产业互联网崛起

在大众创业、万众创新的浪潮下，电子行业中不断涌现出来自中小微企业客户、科研单位、个体工程师等群体的海量个性化需求，但传统样板、小批量企业的服务模式及服务能力已无法满足新业态下的客户需求。随着信息化技术和数字化技术的发展，行业内部分样板、小批量企业开始进行信息化、数字化升级转型，PCB 产业互联网服务模式应运而生，其将新一代信息技术与传统制造模式深度融合，为样板、小批量板客户提供了更为智能化、柔性化的解决方案。

为开辟样板、小批量中高端客户新的经营模式，公司将加快推动互联网接单平台、工程自动

化软件以及珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	1,036,959,929.41	1,049,037,647.58	1,046,092,024.66	-1.15	850,691,150.99
归属于上市公司股东的净资产	692,259,982.98	684,762,312.47	684,536,656.87	1.09	648,195,873.34
营业收入	464,118,043.99	444,659,814.31	444,659,814.31	4.38	564,067,210.66
归属于上市公司股东的净利润	13,469,654.44	46,514,381.62	46,346,051.50	-71.04	64,075,348.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,269,879.51	34,192,711.01	34,024,380.89	-81.66	58,077,389.73
经营活动产生的现金流量净额	37,151,973.85	82,234,364.20	82,234,364.20	-54.82	85,349,442.37
加权平均净资产收益率(%)	1.95	6.98	6.96	减少 5.03个 百分点	11.66
基本每股收益(元/股)	0.10	0.35	0.35	-71.43	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.35	0.35	-71.43	0.52
研发投入占营业收入的比例(%)	7.00	6.66	6.66	增加 0.34个 百分点	6.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	106,514,751.33	111,545,249.05	119,557,706.45	126,500,337.16
归属于上市公司股东的净利润	6,249,335.84	2,616,769.80	1,578,734.77	3,024,814.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,166,358.38	2,013,633.97	234,206.61	1,855,680.55
经营活动产生的现金流量净额	17,204,829.16	9,237,378.74	9,000,966.64	1,708,799.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		7,368						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		6,450						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
马卓		51,573,100	38.66	51,573,100	51,573,100	无		境内 自然 人
联讯德威	-24,700	7,239,200	5.43			无		其他
杨春光		3,807,200	2.85	3,807,200	3,807,200	无		境内 自然 人
吉顺发投资		3,537,400	2.65	3,537,400	3,537,400	无		其他
李雪梅	-45,000	3,120,100	2.34			无		境内 自然 人
高新投投资(SS)	-720,224	2,185,376	1.64			无		国 有 法 人
陈家琼	2,110,193	2,110,193	1.58			无		境内 自然 人
莘兴投资		2,000,000	1.50	2,000,000	2,000,000	无		其他
马颖		1,903,600	1.43	1,903,600	1,903,600	无		境内 自然 人

中国银行股份有限公司一国量化多因子股票型证券投资基金	1,169,680	1,169,680	0.88			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东中，马卓持有吉顺发 20.58%的出资额，持有莘兴 15.95%的出资额并担任两家企业执行事务合伙人，杨春光为马卓配偶之胞弟。深圳市高新投集团有限公司分别持有高新投投资、人才二号基金 100%股权、18%股权，深圳市高新投集团有限公司控制的公司担任人才二号基金执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

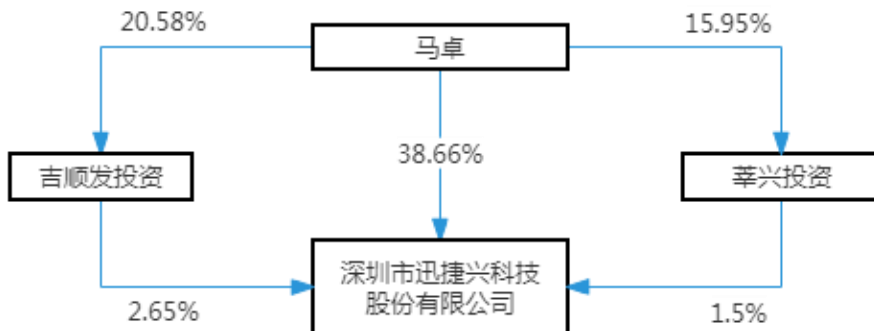
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

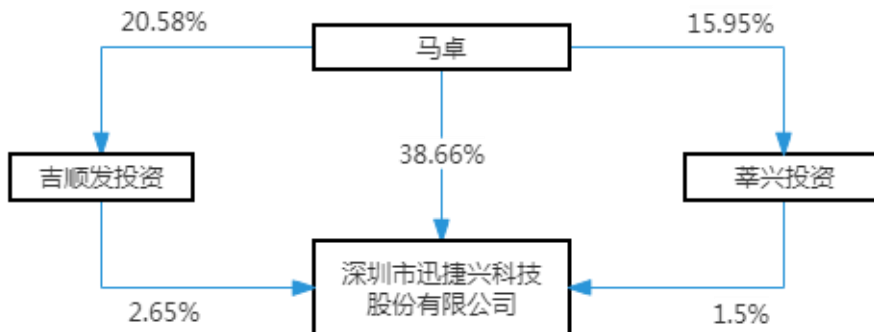
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司实现营业收入 46,411.80 万元，较上年同期上升 4.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,346.97 万元，较上年同期下降 71.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 626.99 万元，较上年同期下降 81.66%。2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,715.20 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用